



PRODUCT SPECIFICATION

LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH**【1. 適用範囲 SCOPE】**

本仕様書は、_____ 殿 に納入する 0.35 mm ピッチ 基板対基板用 コネクタ について規定する。
 This specification covers the 0.35mm PITCH BOARD TO BOARD CONNECTOR series for _____.

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product Name	製品型番 Part Number
リセプタクル ハウジング アッセンブリ Receptacle Housing Assembly	505413**09
505413**09 エンボス梱包品 Embossed Tape Package For 505413**09	505413**10
プラグ ハウジング アッセンブリ Plug Housing Assembly	505417**09
505417**09 エンボス梱包品 Embossed Tape Package For 505417**09	505417**10

REV.	A	B	C	D																									
SHEET	ALL	8	8	8																									
REVISE ON PC ONLY										TITLE:																			
D										REVISED '18/02/08 RMIYAMOTO										0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書									
										THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION																			
REV.	DESCRIPTION																												
DESIGN CONTROL J					STATUS					WRITTEN BY: NNAKAZAWA			CHECKED BY: RTAKEUCHI			APPROVED BY: KMORIKAWA			DATE: 2016/06/16										
DOCUMENT NUMBER 5054130000										DOC. TYPE PS			DOC. PART 001			CUSTOMER GENERAL					SHEET 1 OF 16								
EN-127(2015-12)																													

【3. 定格 RATINGS】

項目 Item	規格 Requirements	
最大許容電圧 Maximum Rated Voltage	50 V [AC (実効値 RMS) / DC]	
最大許容電流 Maximum Rated Current	Terminal:	0.3 A / PIN ^{*1}
	Fitting nail:	3.0 A / PIN
	[AC (実効値 RMS) / DC]	
使用温度範囲 ^{*2} Operating Temperature Range ^{*2}	-40°C~+85°C ^{*3}	
保管条件 Storage Condition	温度 Temperature	-10°C~+50°C
	湿度 Humidity	85%R.H.以下 (但し結露しないこと) Less than 85%R.H. (Non-condensing is required.)
	期間 Terms	出荷後6ヶ月 (未開封の場合) 6 months after shipped. (For unopened package)

*1 : 最大許容電流0.3Aでの使用は最大50極までとする。

但し、50極以上の総電流は各極を合計し、15A以下で使用すること。

0.3 A MAX. /PIN is to applied to 50pins MAX.

A total of 15 A MAX. is to be applied to over 50 pins.

*2 : 基板実装後の無通電状態にも適用されます。

This temperature range shall cover the non-energized surface-mounted connectors.

*3 : 通電による温度上昇分を含む。

This temperature range includes the temperature rise by energization.

【4. 性能 PERFORMANCE】

特別に指定がない限り、測定は以下の条件にて行われること。

Unless otherwise specified, the measurements/tests shall be conducted under the following condition.

Ambient temperature range : 15°C~35°C

Humidity range : 25%~85%

Air pressure : 86kPa~106kPa

但し判定に疑義を生じた場合は、以下の条件にて測定を行う。

However, any question arising out of the result, the measurements/tests shall be re-conducted under the following condition.

Ambient temperature range : 20±1°C

Humidity range : 63%~67%

Air pressure : 86kPa~106kPa

D	REVISE ON PC ONLY	TITLE: 0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書		
	SEE SHEET 1 OF 16	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
REV.	DESCRIPTION	DOCUMENT NUMBER 5054130000	DOC. TYPE PS	DOC. PART 001
		CUSTOMER GENERAL	SHEET 2 OF 16	

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-1	接 触 抵 抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、 短絡電流 10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors and measure contact resistance at less than 20mV of open circuit voltage and less than 10mA of short circuit current. (JIS C5402 5.4)	For Terminal : 80 milliohm MAX. For Nail : 30 milliohm MAX.
4-1-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間、及びター ミナル-ネイル間にDC 250Vを印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors and measure insulation resistance at 250V-DC applied to between terminals and terminal-nail that are adjacent. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	100 mega ohm MIN.
4-1-3	耐 電 圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間、及びター ミナル-ネイル間にAC(RMS) 250V (実効値) を 1 分間 印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors and apply 250V-AC (RMS) to between the terminals and terminal-nail that are adjacent for 1 minute. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	製品機能を損なう異 状なきこと No damage on function.
4-1-4	温 度 上 昇 Temperature Rise	最大許容電流を嵌合されたコネクタに通電し、温度上 昇分を測定する。 (UL 498) Apply maximum rated current to the mated connectors and measure the temperature rise. (UL 498)	30 °C MAX.

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-2-1	挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	1分間 5回以下 の速さで挿入、抜去を行う。 Conduct insert and withdrawal at the speed of less than 5 cycles per minute.	第 6 項参照 Refer to paragraph 6
4-2-2	ターミナル保持力 Terminal / Housing Retention Force	ハウジングに装着されたターミナルを 毎分 25±3mm の速さで引っ張る。 Pull out the terminals assembled to the housing at the speed of 25±3mm per minute.	0.15N {0.015 kgf} Min

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書
D	SEE SHEET 1 OF 16	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER 5054130000	DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL	SHEET 3 OF 16
-------------------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	繰返し挿抜 Repeatedly Insertion / Withdrawal	1分間 5回以下の速さで挿入、抜去を30回 繰返す。 Repeatedly conduct insert and withdrawal up to 30 cycles at the speed of less than 5 cycles per minute.	接触抵抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
4-3-2	耐振動性 Vibration	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 3方向 に掃引割合10~55~10 Hz/分、全振幅 1.5mm の振動を 各2時間 加える。(MIL-STD-202 試験法 201) With energizing 1mA-DC to mated connectors, vibrate for 2 hours each in 3 mutually perpendicular planes with the following conditions; 1.5mm of amplitude, 10~55~10 Hz in 1 minute of sweep time. (MIL-STD-202 Method 201)	外観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接触抵抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
			瞬断 Discontinuity	1.0 micro sec. MAX.
4-3-3	耐衝撃性 Shock	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 6方向 に 490m/s ² { 50G } の衝撃を作用時間11ミリ秒で各3回加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213) With energizing 1mA-DC to mated connectors, give 3 shocks each of 490m/s ² { 50G } in 6 mutually perpendicular planes at duration of 11milliseconds. (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	外観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接触抵抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
			瞬断 Discontinuity	1.0 micro sec. MAX.
4-3-4	耐熱性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、85±2°C の雰囲気中に 96時間 放置後、取り出し1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108) Mate connectors and expose to the atmosphere of 85±2°C for 96 hours, then expose to the room ambient for 1~2 hours. (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202	外観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接触抵抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY

D

SEE SHEET 1 OF 16

TITLE:

0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP
PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
5054130000

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
001

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
4 OF 16

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
		Method 108)		
4-3-5	耐寒性 Cold Resistance	コネクタを嵌合させ、 $-40\pm 3^{\circ}\text{C}$ の雰囲気中に 96時間 放置後、取り出し1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-1) Mate connectors and expose to the atmosphere of $-40\pm 3^{\circ}\text{C}$ for 96 hours, then expose to the room ambient for 1~2 hours. (JIS C60068-2-1)	外観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接触抵抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
4-3-6	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合させ、 $60\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度 90~95% の雰囲気中に96時間 放置後、取り出し1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 試験法 103) Mate connectors and expose to the atmosphere of the condition; $60\pm 2^{\circ}\text{C}$, 90%~95% for 96 hours, then expose to the room ambient for 1~2 hours. (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	外観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接触抵抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項を満足すること Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	50 mega ohm MIN.
4-3-7	温度サイクル Temperature Cycling	コネクタを嵌合させ、 -55°C に30分、 $+85^{\circ}\text{C}$ に30分これを1サイクルとし、5サイクル繰返す。 但し、温度移行時間は5分以内とする。 試験後1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-14) Mate connectors and expose to the test atmosphere for 5 cycles; 1 cycle is -55°C for 30 minutes and $+85^{\circ}\text{C}$ for 30 minutes. Temperature transfer time should be less than 5 minutes. Then expose to room ambient for 1~2 hours. (JIS C60068-2-14)	外観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接触抵抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY

D

SEE SHEET 1 OF 16

TITLE:

0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP
PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
5054130000

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
001

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
5 OF 16

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-8	塩水噴霧 Salt Spray	コネクタを嵌合させ、35±2℃にて 5±1% 重量比の塩水を 48±4時間 噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法 101) Mate connectors and expose to the salt spray atmosphere from the 5±1% solution at 35±2℃ for 48±4 hours, then expose to room ambient for dry after water washed connectors. (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)	外観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接触抵抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
4-3-9	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	コネクタを嵌合させ、40±2℃にて 50±5ppmの亜硫酸ガス中に 24時間 放置する。 Mate connectors and expose to SO ₂ gas atmosphere of 50±5ppm at 40±2℃ for 24 hours.	外観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接触抵抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
4-3-10	半田付け性 Solder ability	ターミナルをフラックスに浸し、245±5℃の半田に 3±0.5秒 浸す。 Dip the terminal in flux, then dip it in solder at 245±5℃ for 3±0.5 sec.	濡れ性 Solder Wettability	浸漬した金めっき面積の95%以上 More than 95% of immersed gold plated area must show no voids or pin holes.

REVISE ON PC ONLY

D

SEE SHEET 1 OF 16

TITLE:

0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP
PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
5054130000

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
001

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
6 OF 16

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-11	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	<リフロー時> 第7項の条件にて、2回リフローを行 う。 <For reflow soldering> Conduct the reflow twice under the condition specified in the paragraph 7.	外 観 Appearance	製品機能を損なう異 状なきこと No damage on function.
		<手半田> 端子及び、金具の半田付部を 350±10℃の半田ゴテにて最大5秒加熱 する。 <For hand soldering> Apply soldering iron heated to 350±10℃ to the soldering tail of terminal or nail for a maximum of 5 seconds.		

D	REVISE ON PC ONLY	TITLE: 0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書			
	SEE SHEET 1 OF 16	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
	REV.	DESCRIPTION			
DOCUMENT NUMBER 5054130000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL	SHEET 7 OF 16
EN-127(2015-12)					

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT APPEARANCE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照 Refer to the drawing.

ELV 及び RoHS適合品 Compliant product for ELV AND RoHS.

【6. 挿入力及び抜去力 INSERTION FORCE AND WITHDRAWAL FORCE】

極数 No. of CKT	単位 UNIT	挿入力(最大値) Insertion force (MAX.)			抜去力(最小値) Withdrawal force (MIN.)		
		初回 1st	6回目 6th	30回目 30th	初回 1st	6回目 6th	30回目 30th
6	N {kgf}	15.0 {1.53}			1.9 {0.19}		
14	N {kgf}	22.3 {2.28}			3.49 {0.35}		
30	N {kgf}	36.0 {3.68}			6.0 {0.61}		
34	N {kgf}	40.8 {4.17}			6.8 {0.69}		
40	N {kgf}	48.0 {4.90}			8.0 {0.81}		
60	N {kgf}	65.0 {6.64}			10.0 {1.02}		

():参考規格 Reference Spec

{ }:参考単位 Reference Unit

REVISE ON PC ONLY

D

SEE SHEET 1 OF 16

TITLE:

 0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP
PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

5054130000

DOC. TYPE

PS

DOC. PART

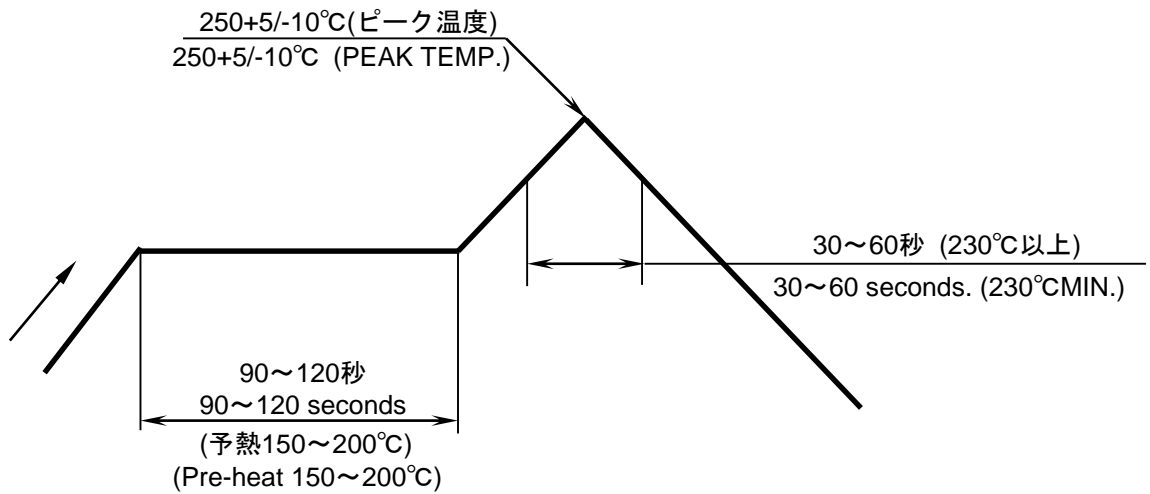
001

 CUSTOMER
GENERAL

SHEET

8 OF 16

【7. 赤外線リフロー条件 INFRARED REFLOW CONDITION】



温度条件グラフ
TEMPERATURE CONDITION GRAPH
 (基板表面温度)
 (TEMPERATURE ON BOARD PATTERN SIDE)

注記 NOTE :

本リフロー条件に関しては、温度プロファイル、半田ペースト、大気、N2リフロー、基板などにより条件が異なりますので事前に実装評価(リフロー評価)を必ず実施願います。実装条件によっては、製品性能に影響を及ぼす場合があります。
 Please check the surface-mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices beforehand, because they may be different by the temperature profile, the solder paste, the atmosphere (Air or Nitrogen) or the type of the boards.
 The different conditions may have an influence on the product's performance.

- ・ 推奨ランド寸法 Recommended Pattern dimension:
SDをご参照下さい。
Refer to the Sales Drawing.
- ・ 推奨メタルマスク厚さ Recommended Thickness of metal mask
t = 0.08 mm
- ・ 推奨メタルマスク開口率 Recommended Open aperture ratio of metal mask
80% (大気リフロー時 for atmosphere)

D	REVISE ON PC ONLY	TITLE: 0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書		
	SEE SHEET 1 OF 16	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
REV.	DESCRIPTION	DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL
DOCUMENT NUMBER 5054130000				SHEET 9 OF 16

【8. 取り扱い上の注意事項 INSTRUCTIONS FOR USE】

[嵌合について- For Mating]

嵌合は極力嵌合軸に沿って平行に行ってください。(図-1)

その際、リセハウジングとプラグの外壁同士を合わせる様に位置決めした後に押し込み嵌合して下さい。斜めの嵌合になる場合は10°以下の角度でリセハウジングとプラグの外壁同士を軽く当て、位置決めした後に嵌合して下さい。(図-2)

尚、リセハウジング内壁とプラグ内壁とを当てた(支点とした)状態で嵌合を行いますと、反支点側のリセハウジングとプラグの外壁が干渉し、ハウジングが破壊する恐れがありますのでこのような嵌合はお避け下さい。(図-3)

Please mate the connector horizontally along the mating direction shown below. (See figure1)

Please correctly position the outside wall of housing of the plug with the inside of the receptacle housing and mate them together.

In case of diagonal mating, please ensure that the leading angle is a maximum of 10 degrees. (See figure 2)

Please avoid mating the connectors and then rotating them when they are in the mated condition because it may damage the housing on the plug or receptacle. (See figure3)

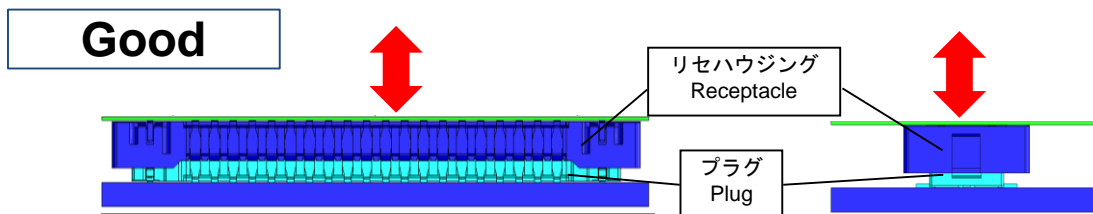


図-1 平行状態での挿抜 Fig.1 Mating / Un-mating in parallel manner

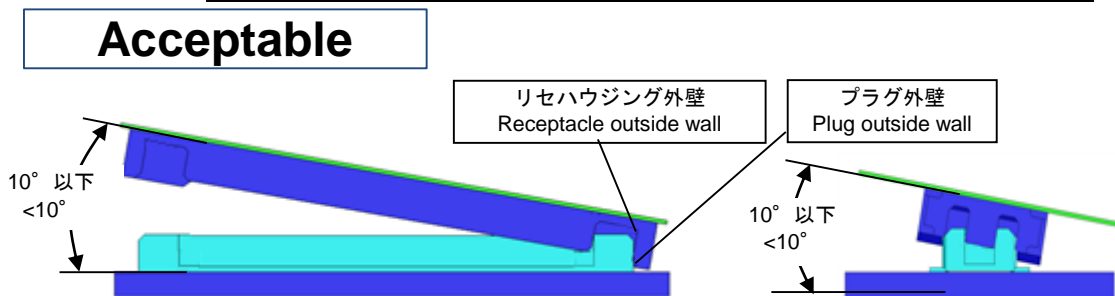


図-2 外壁合わせによる嵌合 Fig.2 Diagonal mating by aligning Plug outside wall

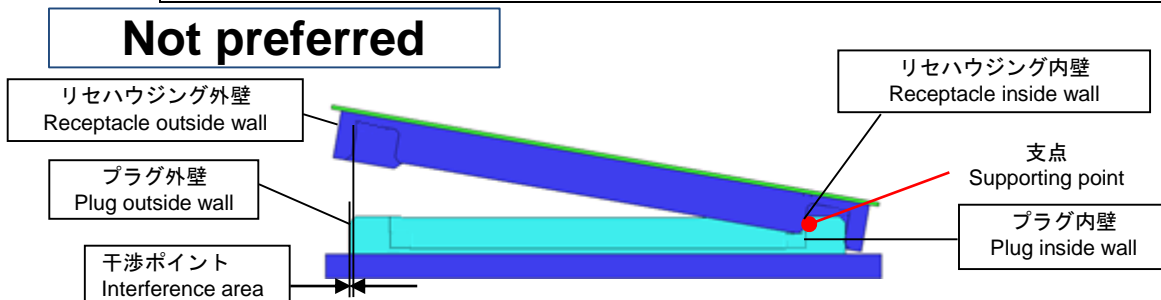


図-3 内壁合わせによる嵌合 Fig.3 Diagonal mating by aligning Plug inside wall

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
D	SEE SHEET 1 OF 16	0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 5054130000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL	SHEET 10 OF 16

[抜去について- For Un-mating]

抜去は極力嵌合軸に沿って平行に行ってください。(図- 1)

または、左右に少しずつ振りながら行ってください。(図- 4)

過度のこじり抜去には注意してください。過度のこじり抜去ではコネクタが破壊する可能性があります。(図- 5)

Please un-mate the connector horizontally along the mating direction shown below. (See figure 1)

Or please un-mate the connector by lightly shaking it from side to side. (See figure 4)

Please be very careful when un-mating the connector at an angle.

This may cause damage to the connector. (See figure 5)

Good

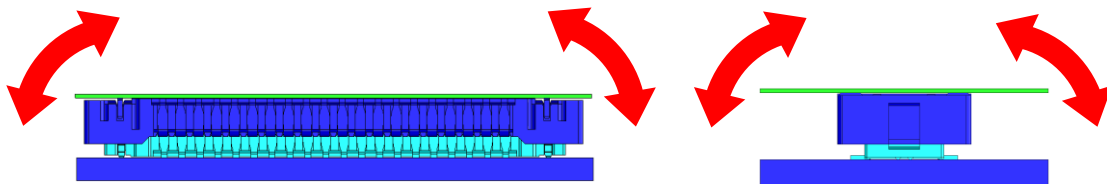


図- 4 抜去 Fig.4 Un-mating by shaking side to side

Not preferred

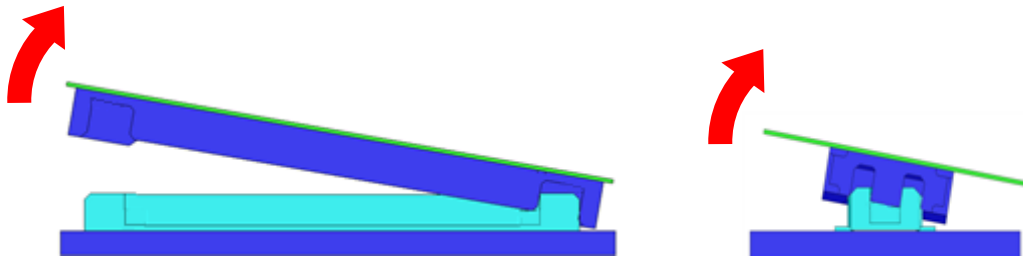


図- 5 こじり抜去 Fig.5 Un-mating with one strong rotation

D	REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
	SEE SHEET 1 OF 16	0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書			
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 5054130000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL	SHEET 11 OF 16
EN-127(2015-12)					

【9. その他 注意事項 OTHER PRECAUTIONS】

- 外観について For Appearance
 1. 本製品の樹脂部に黒点、ウエルド部の線、多少の傷や微小の気泡等が確認される事がありますが、製品性能には影響ございません。
Although this product may have a small black mark, a weld line, a scratch or minim air bubbles on the housing, these will not have any influence on the product's performance.
 2. 成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、製品性能には影響ありません。
There may be slight differences in the housing coloring, but there will be no influence on the product's performance.
- 実装について For surface mounting process
 3. 本リフロー条件に関しては、温度プロファイル、半田ペースト、大気、N2リフロー、基板などにより条件が異なりますので事前に実装評価(リフロー評価)を必ず実施願います。
実装条件によっては、製品性能に影響を及ぼす場合があります。
Please check the surface-mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices beforehand, because they may be different by the temperature profile, the solder paste, the atmosphere (Air or Nitrogen) or the type of the boards.
The different conditions may have an influence on the product's performance.
 4. 実装性能(平坦度)は、実装基板の反りの影響を含まないものと致します。
基板の反りはコネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にてMax0.02mmとして下さい。
The mounting specification (i.e.: Coplanarity) shall not be had the influence from warpage of the P.W. Board.
The warpage of the P.W. Board at the central part of the connector shall be a maximum of 0.02mm from the datum line on the both edge.
 5. 本製品の一般性能確認はリジット基板にて実施おります。フレキシブル基板等の特殊な基板へ実装する場合は、事前に実装確認等を行った上でご使用願います。
The product performance is tested using P.W. Board. In case of the product to be surface-mounted onto the Flexible Printed Circuit board, please conduct a reflow soldering test with the board in advance.
 6. フレキシブル基板に実装する場合は、基板の変形を防止するため、補強板をご使用願います。
本製品は低背のため、接点部へのはんだ上がりが発生しない様リフロー条件を設定して下さい。
Please apply a stiffener to prevent deformation of the board if the connector is surface-mounted onto the Flexible Printed Circuit board.
Due to low height design, please set proper reflow soldering condition to prevent solder wicking up to the contact region.

D	REVISE ON PC ONLY	TITLE: 0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書			
	SEE SHEET 1 OF 16				
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 5054130000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL	SHEET 12 OF 16
EN-127(2015-12)					

7. リフロー条件によっては、樹脂部の変色や膨らみ、端子めっき部にヨリが発生する場合があります。しかし製品性能に影響はございません。
Depending on the reflow conditions, there may be the possibility of a color change or any deformation on the housing, or wavy surface on plating region.
However, these will not have any influence on the product's performance.
8. リフロー後、半田付け部に変色が見られることがありますが、製品性能に影響はありません。製品仕様上、テール上面まで半田濡れ上がりはありませんが、製品性能上問題ありません。
Although there may be discoloration appeared on the soldering tail after reflow, this will not have any influence on the product's performance.
Depending on the product design, there may be no solder on the top of tails, but there will be no influence on the product's performance.
9. 本製品は端子先端部にカット面がある為に、端子先端部の実装性(基板への半田付け性)は、端子側面・後側に比べて悪くなります。しかし、側面及び後側においてフィレットが形成されていれば、機能及び強度に問題はなりません。
Because this product has a cutoff area at the tip of the tails, the solderability performance in the area may be inferior as compared with the one at the side / back of the tails.
However, by making a good soldering fillet at the side / back of the tails, there will be no issue on the product function and the stiffness.
10. 半田実装部の未半田は、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタの基板からの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及び、ネイル部に半田付けを行って下さい。
Insufficient solder may cause dropping terminal off from housing, short circuit between terminals, terminal buckling or dropping connector off from the P.W. Board. Therefore, please ensure to solder all of the terminals and fitting nails onto the P.W. Board.
11. 実装機によってコネクタに負荷が加わると変形、破損する場合がありますので事前にご確認下さい。
If there is any accidental contact with the connector while it is going through the mounter, there may be deformation or damage on the connector. Please run a trial in advance.
12. 基板実装前に端子周辺の成形品に過度の荷重を掛けないで下さい。
Prohibit from applying an excessive load to the housing around terminals before surface-mounting onto P.W. Board.
13. 基板実装後に基板を直接積み重ねない様に注意してください。
Please be careful not to stack up the P.W. Board directly that the connector was surface-mounted.
14. 実装時は位置決めマーク（フィデューシャルマーク）等を設け、実装ずれに注意してください。過度な実装ずれが起きた場合、接点部への半田上がりが発生する可能性があります。
Please be careful not to make improper mounted connectors by putting fiducial marks.
If the connector excessively shifted, it may cause the solder wicking up to the contact area.
15. 実装条件（基板、メタルマスク、クリーム半田など）により、コネクタの実装状態（半田上がり）が異なる場合があります。
Please be noted the fillet condition may be different by the mounting condition.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
D	SEE SHEET 1 OF 16	0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 5054130000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL	SHEET 13 OF 16
EN-127(2015-12)					

16. 本製品をSn-Ag-Cu系(重量比96.5%-3%-0.5%)以外の半田でご使用される場合は、事前に半田付け性、半田剥離強度などをご確認ください。If an alternative solder past other than Sn-Ag-Cu (Weight ratio: 96.5%-3%-0.5%), please ensure the solder-ability and the peel strength in advance.

● 製品の仕様について For product specification

- 17. コネクタの性能を損なう恐れがある為、コネクタの洗浄は行わないで下さい。
Please do not conduct any "washing process" with the connector not to lose the product's function.
- 18. 本製品をご使用時に取り付けられた電線・プリント基板の共振や、機器の回転構造や可動部分の動作によりコネクタ嵌合部(接点部)が常に動いてしまう状態での御使用は避けて下さい。接触部の摺動磨耗等による接触不良の原因となります。従って、機器内で電線・プリント基板を固定し、共振を抑える等の処置をお願い致します。
Please do not use the connector in a condition where the wire, the P.W. Board, or the contact area is experiencing a sympathetic vibration of wires and P.W. Board, and constant movement of devices. This may cause a defect in the contact due to the contact area being worn down. Therefore, please fix wires or P.W. Board on the chassis, and reduces sympathetic vibration.
- 19. 活電状態の電気回路で、挿入、抜去ができることを前提に作られていません。スパーク等による危険の発生、性能不良につながりますので、活電状態での挿入、抜去はしないで下さい。
This product is not designed so that the connectors can mate or un-mate each other under the condition of an active electrical circuit. Prohibit from mating or un-mating the connectors under the condition since it may cause a spark and product defect.
- 20. コネクタのみで基板を支えることは避け、コネクタ以外での基板固定対策を行ってください。
Please do not use the connector alone to hold the P.W. Board and make other safety measures to hold the boards.
- 21. 一枚の基板にコネクタを複数実装する場合は、嵌合相手側はそれぞれ個別の基板に実装してご使用を願います。
Please use the connector surface-mounted on the separated boards in case of a number of the other side of the connector was surface-mounted on one board.
- 22. コネクタに外力が加わらないようにクリアランスをあけた筐体構造にしてください。
Please keep enough clearance between connector and chassis of the application to avoid any external forces to the connector.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
D	SEE SHEET 1 OF 16	0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 5054130000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL	SHEET 14 OF 16
EN-127(2015-12)					

● 製品の取り扱いについて For product handling

- 23. 基板実装前後に端子、補強金具に触らないでください。
Please be careful not touch the terminals and fitting nails before / after the connector is / was surface-mounted onto the P.W. Board.
- 24. 嵌合の際、嵌合が不十分にならないようご注意ください。また、セットへの組み込み後も、振動、衝撃等で嵌合の浮きが発生しないような状態にて使用してください。嵌合が浮き、基板同士あるいは基板とFPCが5度以上傾くと嵌合が抜ける可能性があります。
Please ensure that the connectors are fully mated. Also, please ensure that the connector does not become unengaged by any vibrations or shocks after set the connector in the device.
There may be case of coming off the connectors if the mating was insufficient or the boards got an inclination of more than 5 degrees.
- 25. 嵌合後、コネクタピッチ方向、スパン方向及び回転方向への負荷がかかるような動作またはセットはしないでください。コネクタ破壊やはんだクラックを引き起こします。
Please do not make any turns or sets which apply any loads in pitch, span or torque directions to the mated connectors.
It may cause damage to the connectors or crack on the solder.

● リペアについて For repair

- 26. 実装後において半田ごてによる手修正を行う際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行って下さい。条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、熔融等、破損の原因になります。
If any repairs by hand using a soldering iron are required, please follow the soldering conditions specified in this product specification.
If the conditions were not followed, it may cause dropping the terminals off from housing, changes in the contact gaps or any damages on housing like deformation or melting.
- 27. 半田ごてによる手修正を行なう際、過度の半田やフラックスを使用しないで下さい。半田上がりやフラックス上がりにより接触、機能不良に至る場合があります。
If any repairs by hand using a soldering iron are required, please be careful not to use excess solder or flux. This may cause contact defects or functional issues by solder / flux wicking up to contact area.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
D	SEE SHEET 1 OF 16	0.35 BB CONN. H=1.0 SSB10RP PRODUCT SPECIFICATION / 製品仕様書			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 5054130000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL	SHEET 15 OF 16
EN-127(2015-12)					

